



MSL FPGA INC 晶片參數

■ 芯片概述

V6118V4QF52D+是来自MSL FPGA INC美时龙的一款芯片，采用52引脚QFP封装，属于四侧引脚扁平封装类型，引脚间距通常为0.5mm或0.8mm。以下是其关键信息：

■ 核心参数

工作电压：3.3V或5V（常见于工业级芯片）
温度范围：-40 °C至85 °C（工业级标准）
通信接口：可能支持SPI/I2C（参考QFP封装常见功能）

■ 功能特性

高集成度：QFP封装通常集成处理器、存储及外设接口，简化外围设计。
EMI抑制：金属屏蔽罩设计可减少电磁干扰。
多协议支持：可能兼容PWM或模拟调光（参考电源管理芯片特性）。

■ 应用场景

工业控制：如PLC、传感器信号处理。
消费电子：智能家居设备的主控模块。
电源管理：若为电源芯片，可能用于LED驱动或电池管理系统。